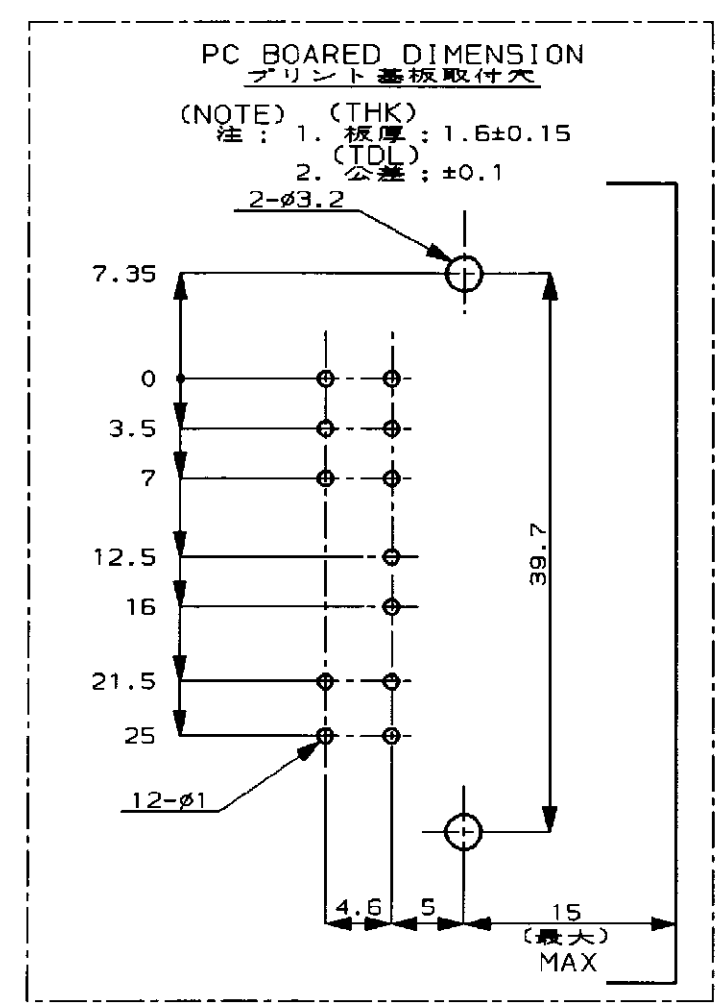
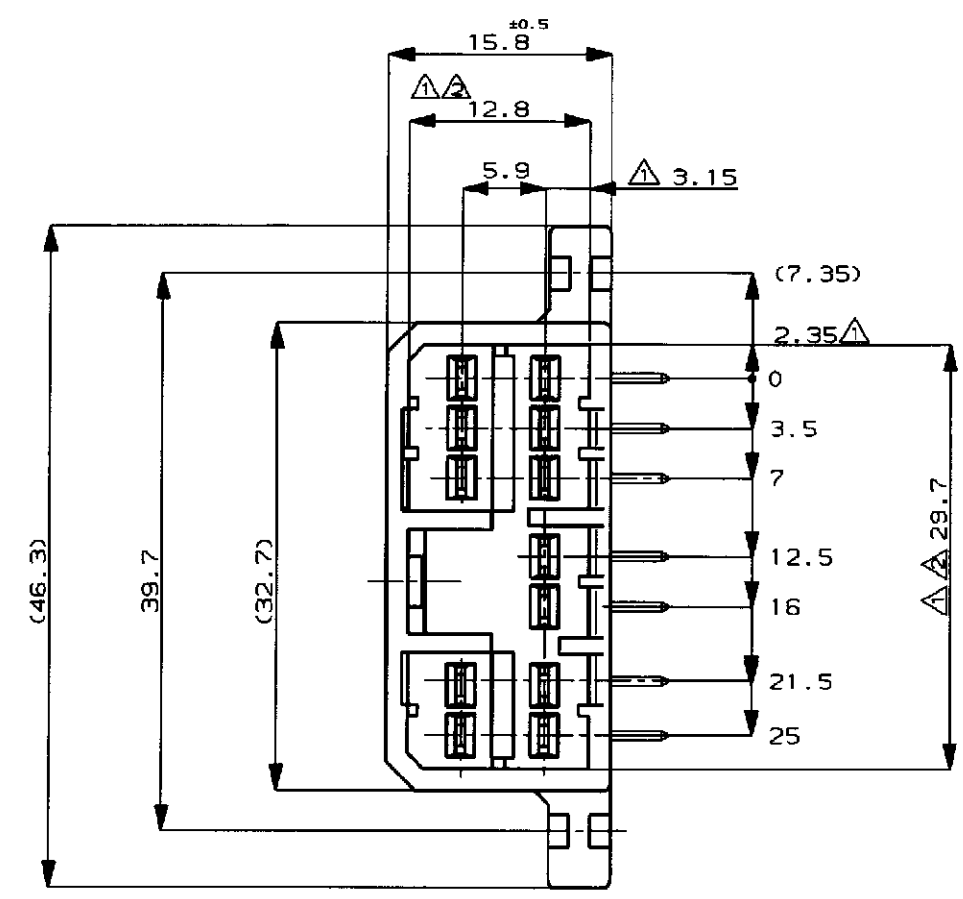
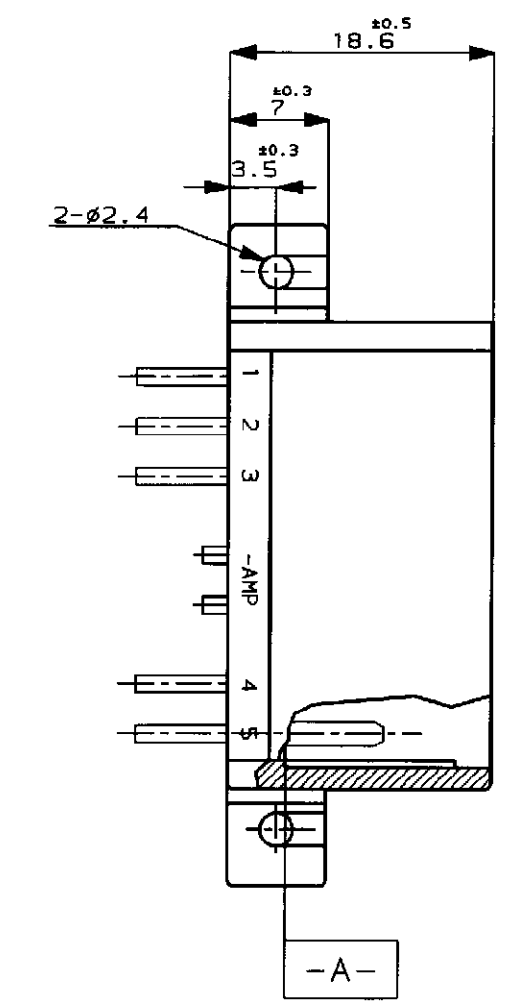
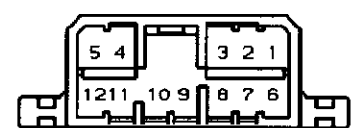


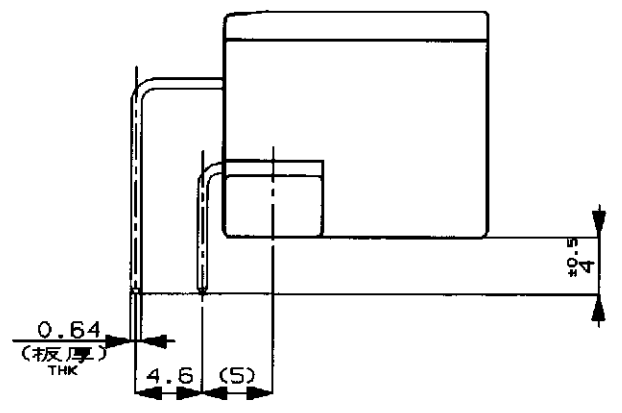


注 : △ A-A面より2mmの範囲で測定
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
3 プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122,M3X6ナベ
(2種又は4種)のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する
(締付トルク : 4kg-cm以下)
△ 回路番号 : 下図参照のこと。
△ P/N 2-173858-6のタブの位置は、回路番号の1,3,5,6,8,10,12とする。

NOTES : △ TO BE MEASURED BETWEEN A-A AND 2
△ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3 TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122
(TYPE2 OR 4) BEFORE SOLDER
△ CIRCUIT NUMBER



△ TAB POSITIONS OF P/N 2-173858-6;CIRCUIT
NUMBER 1,3,5,6,8,10,12



	△ 錫めっき (PRE-TIN)	灰 (GRAY)	2-173858-6
	はんだめっき (POST TIN-LEAD)	灰 (GRAY)	3-173858-2
	はんだめっき (POST TIN-LEAD)	白 (WHITE)	3-173858-1
1~12 (全極)	部分金めっき (GOLD)	緑 (GREEN)	2-173858-4
	錫めっき (PRE-TIN)	白 (WHITE)	9-173858-1
	錫めっき (PRE-TIN)	灰 (GRAY)	173858-6
1~12 (全極)	部分金めっき (GOLD)	白 (WHITE)	2-173858-1
	錫めっき (PRE-TIN)	緑 (GREEN)	173858-4
	錫めっき (PRE-TIN)	白 (WHITE)	173858-1
金めっきタブ回路NO. (SELECTIVE GOLD C/N) △	コンタクト仕上げ (FINISH OF CONTACT)	色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright © 1988 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP (JAPAN) LTD. Tokyo, Japan			
REVISED FJ00-0501-98		AWG		WIRE RANGE		INSULATION DIA	
2- -6 追加 FJ00-3133-95		SO KO		mm ² (AWG)		mm	
3- -2 追加 FJ00-0740-93		KA KA		MATERIAL		FINISH	
3- -1 追加 J-0398		T.S K.A		ハウジングHSG,PBT		表参照 (SEE TABLE)	
REVIS J-12308		T.S K.A		コンタクトCONT.:BRASS		NAME	
-6 追加 J-10751		Y.F T.S		DR. Y.FUJIMORI		.070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN.12Pos.(H) CAP HSG	
再作成 J-10560		Y.F T.S		CHK. T.SAGAWA		.070シリーズ マルチロック I/Oコネクタ	
REVISION RECORD		DR		APP. T.SAGAWA		12極 水平型キャップハウジング	
		DATE		11/4'88		GENERAL TOLERANCE	
						0<X≤10 : ±0.2	
						10<X≤30 : ±0.25	
						30<X≤100 : ±0.3	
						ANGLES : ±3°	
						LOC	
						B J	
						NUMBER	
						C-173858	
						SCALE	
						2-1	
						REV.	
						G	
						SHEET	
						- OF -	